

สารบัญ	หน้า
บทคัดย่อ.....	5
ABSTRACT.....	6
กิตติกรรมประกาศ.....	7
สารบัญ.....	8
รายการตาราง.....	11
รายการรูป.....	13
บทที่ 1 บทนำ.....	18
1.1 ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย.....	18
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	19
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย.....	19
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	20
บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	21
2.1 เทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์.....	21
2.2 การเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์จากการเบนเดนค์.....	26
2.3 ความสามารถในการเข้ากันได้ของพอลิเมอร์เบนเดนค์.....	30
2.4 ยางธรรมชาติ.....	34
2.4.1 โครงสร้างของไมเลกุลยางธรรมชาติ.....	34
2.4.2 สมบัติทั่วไปของยางธรรมชาติ.....	35
2.5 การดัดแปลงไมเลกุลยางธรรมชาติโดยการทำปฏิกิริยาการฟื้นฟูพอลิเมอร์.....	
กับอนุพันธ์มาเลอิไมค์.....	37
2.6 การเกิดพันธะกันระหว่างยางธรรมชาติมาเลอิเอตและพอลิเอไมค์.....	38
2.7 ไนลอน.....	41
2.8 การปรับรูปของพอลิเมอร์เบนเดนค์.....	42
2.9 การวิเคราะห์เชิงความร้อน.....	43

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.10 การวิเคราะห์สมบัติเชิงกลแบบพลวัต.....	44
2.11 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบลนด์และเทอร์โนพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์.....	
ที่เกี่ยวข้องกับยางธรรมชาติและไนลอน 6.....	46
บทที่ 3 สารเคมี อุปกรณ์ และวิธีการทดสอบ.....	49
3.1 สารเคมี.....	49
3.2 อุปกรณ์.....	52
3.3 วิธีการทดสอบ.....	59
3.3.1 การเตรียม เอ็น-(4-ไอครอฟิฟินิล)มาลิอิไมด์ (HPM).....	59
3.3.2 การเตรียมกราฟต์โคโพลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับ HPM.....	59
3.3.3 การวิเคราะห์การเกาะติดของ HPM บนไม้เลกุลยางธรรมชาติ.....	59
3.3.4 การวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนของยางธรรมชาติกราฟต์ด้วย HPM.....	60
3.3.5 การเตรียมพอลิเมอร์เบลนด์โดยกระบวนการรีแอคทิฟเบลนด์.....	60
3.3.6 การเตรียมชิ้นทดสอบด้วยเครื่องนีดเกอร์โนพลาสติก.....	61
3.3.7 การทดสอบสมบัติต่าง ๆ	62
3.3.7.1 การทดสอบสมบัติความด้านทานต่อแรงดึง.....	62
3.3.7.2 การทดสอบความสามารถในการยึดจันขาด.....	63
3.3.7.3 การทดสอบสมบัติเชิงกลพลวัตด้วยเครื่อง.....	63
3.3.7.4 การทดสอบความด้านทานต่อตัวทำละลาย.....	63
3.3.7.5 การวิเคราะห์ลักษณะทางด้านสัมฐานวิทยา.....	64
3.3.7.6 การวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อน.....	64
บทที่ 4 ผลการทดสอบและวิจารณ์ผล.....	65
4.1 การเตรียม เอ็น-(4-ไอครอฟิฟินิล)มาลิอิไมด์ และการวิเคราะห์โครงสร้าง.....	65
4.2 การเตรียมกราฟต์โคโพลิเมอร์ระหว่างยางธรรมชาติกับ HPM.....	69
4.3 สมบัติเชิงความร้อนของยางธรรมชาติที่คัดแปลง ไม้เลกุลด้วย HPM.....	79

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.4 การเตรียมพอลิเมอร์เบลนด์จากการรีแอคทีฟเบลนด์ของยางธรรมชาติด้วย HPM กับไนโอลอน 6.....	81
4.5 สมบัติของพอลิเมอร์เบลนด์จากการรีแอคทีฟเบลนด์ที่ได้จากการเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติด้วย HPM กับไนโอลอน 6.....	82
4.5.1 สมบัติด้านการดึงของพอลิเมอร์เบลนด์จากการรีแอคทีฟเบลนด์.....	82
4.5.2 สมบัติเชิงกลพลวัตของพอลิเมอร์เบลนด์โดยกระบวนการรีแอคทีฟเบลนด์.....	92
4.5.3 ความด้านทานต่อตัวทำละลายของพอลิเมอร์เบลนด์โดยกระบวนการรีแอคทีฟเบลนด์.....	97
4.5.4 ลักษณะทางสัมฐานวิทยาของพอลิเมอร์เบลนด์โดยกระบวนการรีแอคทีฟเบลนด์.....	101
4.5.5 สมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์เบลนด์โดยกระบวนการรีแอคทีฟเบลนด์.....	106
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง.....	113
5.1 การเตรียม เอ็น-(4-ไฮดรอกซิพินิล)มาลิอิไมค์ และการวิเคราะห์โครงสร้าง.....	113
5.2 การเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ระหว่างยางธรรมชาติกับ HPM.....	113
5.3 การเตรียมพอลิเมอร์เบลนด์โดยกระบวนการรีแอคทีฟเบลนด์ของคู่เบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติด้วย HPM กับไนโอลอน 6.....	114
บรรณานุกรม.....	115
ภาคผนวก ก ลักษณะของ เอ็น-(4-ไฮดรอกซิพินิล)มาลิอิไมค์ (HPM).....	119
ภาคผนวก ข นิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) จากการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในงานประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 21 ประจำปี 2554.....	121
ประวัติผู้เขียน.....	130

รายการตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ความต้านทานต่อการสึกหรอของยางชนิดต่างๆ.....	36
3.1 การตั้งค่าของเครื่องฉีด.....	61
4.1 แผนกรูดคลินรังสีอินฟราเรดของหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ ของ HPM.....	67
4.2 ข้อมูล $^1\text{H-NMR}$ ของ HPM (500 MHz, CDCl_3).....	68
4.3 อัตราส่วนความสูงของพีกที่เลขที่คลิน 1712 ต่อ 831 cm^{-1} ที่แปรปริมาณ HPM ในการเตรียมปฏิกิริยา.....	71
4.4 ปริมาณเจลเมื่อแปรปริมาณ HPM ในปฏิกิริยา.....	72
4.5 อัตราส่วนความสูงของพีก (peak height ratio) ที่เลขคลิน 1712 ต่อ 831 cm^{-1} ที่อุณหภูมิการเตรียมปฏิกิริยาต่างๆ.....	75
4.6 อุณหภูมิการถ่ายตัวสูงสุดของยางธรรมชาติ และยางธรรมชาติติดแปลงด้วย HPM.....	80
4.7 ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมพอลิเมอร์เบلنด์จากกระบวนการรีแอคทีฟเบلنด์ ระหว่างยางธรรมชาติติดแปลงด้วย HPM 2 phr กับไนลอน 6.....	81
4.8 ค่าความต้านทานต่อแรงดึงและค่าความสามารถในการยึดจันขาดของพอลิเมอร์เบلنด์ ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 ในอัตราส่วนต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ 230°C	86
4.9 ค่าความต้านทานต่อแรงดึงและค่าความสามารถในการยึดจันขาดของพอลิเมอร์เบلنด์ ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 ในอัตราส่วนต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ 240°C	88
4.10 ค่าความต้านทานต่อแรงดึงและค่าความสามารถในการยึดจันขาดของพอลิเมอร์เบلنด์ ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 ในอัตราส่วนต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ 250°C	90
4.11 การบวนพองในตัวทำละลายของพอลิเมอร์เบلنด์ที่เตรียมจากการเบلنด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 ในอัตราส่วนต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ 230°C	97
4.12 การบวนพองในตัวทำละลายของพอลิเมอร์เบلنด์ที่เตรียมจากการเบلنด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 ในอัตราส่วนต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ 240°C	99
4.13 การบวนพองในตัวทำละลายของพอลิเมอร์เบلنด์ที่เตรียมจากการเบلنด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 ในอัตราส่วนต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ 250°C	100

รายการตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.14 แสดงอุณหภูมิการสลายตัวของพอลิเมอร์เบลนด์เมื่อпрессอัตราส่วนที่อุณหภูมิ 230°C	108
4.15 แสดงอุณหภูมิการสลายตัวของพอลิเมอร์เบลนด์เมื่อпрессอัตราส่วนที่อุณหภูมิ 240°C	110
4.16 แสดงอุณหภูมิการสลายตัวของพอลิเมอร์เบลนด์เมื่อпрессอัตราส่วนที่อุณหภูมิ 250°C	112

รายการรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกโพลีเมอร์.....	21
2.2 ลักษณะของสายโซ่ไม้เล็ก Kulix ของเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกโพลีเมอร์.....	22
2.3 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการเบلنด์ระหว่าง hard polymer และ elastomer.....	24
2.4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการเบلنด์ด้วยกระบวนการไนโตรมิกวัลคานิซ.....	25
2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความหนืดที่ใช้ในการเบلنด์กับอัตราส่วนการผสมของโพลีเมอร์สององค์ประกอบ.....	27
2.6 อิทธิพลของค่าความสามารถในการละลายต่อขนาดอนุภาคของโพลีเมอร์เบلنด์.....	28
2.7 การเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์จากการวัดค่าไนซ์แบบไนโตรมิกส์.....	30
2.8 ตำแหน่งของโพลีเมอร์ร่วมแบบกราฟต์ และบล็อกที่ทำหน้าที่เป็นตัวประสานความเข้ากันได้.....	33
2.9 ปฏิกริยาที่เกิดขึ้นระหว่างหมู่แอนไฮไดรค์ กับหมู่เอมีนของโพลีอิมิค.....	34
2.10 โครงสร้างไม้เล็ก Kulix ของยางธรรมชาติ.....	35
2.11 โครงสร้างไม้เล็ก Kulix ของอนุพันธ์มาลิอิมิค.....	37
2.12 ปฏิกริยาที่เป็นไปได้ระหว่างมาลิอิคแอนไฮไดรค์ ยางธรรมชาติ และโพลีอิมิค 6 ที่เกิดขึ้นในระหว่างทำการผสม.....	40
2.13 เทอร์โมแกรมจากการวิเคราะห์ด้วย TGA ของโพลีคาร์บอเนต.....	43
2.14 กราฟของความเครียดที่ให้กับชิ้นทดสอบและความเกินตอบสนองเป็นฟังก์ชันกับ ωt	45
3.1 ชุดอุปกรณ์สังเคราะห์สาร.....	52
3.2 ฟูเรียร์ทรายส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกตร์ ไฟฟ์คอมิเตอร์.....	53
3.3 เครื่องผสมแบบปิด.....	54
3.4 เครื่องบดพลาสติก.....	54
3.5 เครื่องฉีดเทอร์โมพลาสติก.....	55
3.6 เครื่องทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง.....	56

รายการรูป (ต่อ)

หัวข้อ	หน้า
3.7 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน.....	57
3.8 เครื่องวิเคราะห์ความเสถียรต่อความร้อน.....	58
3.9 เครื่องวิเคราะห์สมบัติพลวัตเชิงกล.....	58
3.10 การตั้งอุณหภูมิที่ใช้ในการฉีด.....	61
4.1 ปฏิกิริยาการเตรียม เอ็น-(4-ไฮดรอกซิพิโนล)มาลิอิไมค์.....	65
4.2 อินฟราเรดスペกตรัมของ HPM.....	66
4.3 โปรตอนเอ็นเอ็มอาร์スペกตรัม (500 MHz, CDCl ₃) ของ HPM.....	68
4.4 อินฟราเรดスペกตรัมของ HPM เมื่อยับกับ NR-g-HPM และ NR.....	69
4.5 สเปกตรัมอินฟราเรดของยางธรรมชาติที่กราฟต์ติดด้วย HPM ที่ปริมาณการใช้ 2, 4, 6, 8 และ 10 phr เมื่อยับกับยางธรรมชาติ.....	70
4.6 อิทธิพลของปริมาณ HPM ในปฏิกิริยาต่อระดับการเกาะติดของ HPM บนไม้เลกุล NR.....	71
4.7 อิทธิพลของปริมาณอนอเมอร์ HPM ต่อปริมาณเจล.....	72
4.8 สเปกตรัมอินฟราเรดของ NR-g-HPM ที่อุณหภูมิการเตรียมปฏิกิริยาต่าง ๆ	73
4.9 กลไกการเกาะติดของ HPM บนไม้เลกุลยางธรรมชาติแบบพันธะคู่อยู่นอกสายโซ่หลัก.....	74
4.10 กลไกการเกาะติดของ HPM บนไม้เลกุลยางธรรมชาติแบบพันธะคู่อยู่ในสายโซ่หลัก.....	74
4.11 อิทธิพลของอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยากราฟต์โพลิเมอร์ไซร์ต่อปริมาณการเกาะติด ของ HPM 2 phr บนไม้เลกุล.....	76
4.12 การเกิดไฮโตรเพอร์ออกไซด์และการตัดสายโซ่ต่องดำเนินการเบื้องต้นของยางธรรมชาติ.....	78
4.13 สเปกตรัมอินฟราเรดของ NR, NR 200 และ NR-g-HPM.....	79
4.14 เทอร์โมแกรม TGA ของ NR และ NR-g-HPM.....	79
4.15 เทอร์โมแกรม DTG ของ NR และ NR-g-HPM.....	80
4.16 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดของพอลิเมอร์เบลนด์ ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 โดยแบร์สัดส่วนการเบลนด์ 50/50 40/60 และ 30/70 และแปรปริมาณสารเพิ่มความเข้ากันได้ที่ Ma 0.5% และ Ma 1% ของพอลิเมอร์ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 230°C.....	83

รายการรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.17 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 โดยแบร์สัดส่วนการเบลนด์ 50/50 40/60 และ 30/70 และแปรปริมาณสารเพิ่มความเข้ากันได้ที่ Ma 0.5% และ Ma 1% ของพอลิเมอร์ทั้งหมดที่อุณหภูมิ 240°C.....	84
4.18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 โดยแบร์สัดส่วนการเบลนด์ 50/50 40/60 และ 30/70 และแปรปริมาณสารเพิ่มความเข้ากันได้ที่ Ma 0.5% และ Ma 1% ของพอลิเมอร์ทั้งหมดที่อุณหภูมิ 250°C.....	85
4.19 ความด้านทานต่อแรงดึงของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 ในอัตราส่วนต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ 230°C.....	87
4.20 ความสามารถในการยึดจันขาดของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 ในอัตราส่วนต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ 230°C.....	87
4.21 ความด้านทานต่อแรงดึงของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 ในอัตราส่วนต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ 240°C.....	89
4.22 ความสามารถในการยึดจันขาดของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 ในอัตราส่วนต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ 240°C.....	89
4.23 ความด้านทานต่อแรงดึงของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 ในอัตราส่วนต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ 250°C.....	91
4.24 ความสามารถในการยึดจันขาดของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 ในอัตราส่วนต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ 250°C.....	91
4.25 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามอคูลัสสะสมกับอุณหภูมิของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon6 เมื่อแบร์สัดส่วนการเบลนด์ ที่อุณหภูมิ 230°C.....	93
4.26 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Tan δ กับอุณหภูมิของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon6 เมื่อแบร์สัดส่วนการเบลนด์ ที่อุณหภูมิ 230°C.....	94

รายการรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.27 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามอคูลัส静态สมกับอุณหภูมิของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon6 เมื่อเปรียบส่วนการเบลนด์ที่อุณหภูมิ 240°C.....	95
4.28 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Tan δ กับอุณหภูมิของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon6 เมื่อเปรียบอัตราส่วนการเบลนด์ที่อุณหภูมิ 240°C.....	95
4.29 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามอคูลัส静态สมกับอุณหภูมิของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon6 เมื่อเปรียบส่วนการเบลนด์ที่อุณหภูมิ 250°C.....	96
4.30 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Tan δ กับอุณหภูมิของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon6 เมื่อเปรียบอัตราส่วนการเบลนด์ที่อุณหภูมิ 230°C.....	96
4.31 ความด้านทานต่อตัวทำละลายของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 ที่ อุณหภูมิ 230°C ในอัตราส่วนต่าง ๆ.....	98
4.32 ความด้านทานต่อตัวทำละลายของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 ที่ อุณหภูมิ 240°C ในอัตราส่วนต่าง ๆ.....	99
4.33 ความด้านทานต่อตัวทำละลายของพอลิเมอร์เบลนด์ระหว่าง NR-g-HPM/Nylon 6 ที่ อุณหภูมิ 250°C ในอัตราส่วนต่าง ๆ.....	100
4.34 ลักษณะสัมฐานวิทยาของพอลิเมอร์เบลนด์ที่เตรียมจาก NR-g-HPM/Nylon 6 เมื่อเปรียบอัตราส่วนการเบลนด์ที่อุณหภูมิ 230°C.....	103
4.35 ลักษณะสัมฐานวิทยาของพอลิเมอร์เบลนด์ที่เตรียมจาก NR-g-HPM/Nylon 6 เมื่อเปรียบอัตราส่วนการเบลนด์ที่อุณหภูมิ 240°C.....	104
4.36 ลักษณะสัมฐานวิทยาของพอลิเมอร์เบลนด์ที่เตรียมจาก NR-g-HPM/Nylon 6 เมื่อเปรียบอัตราส่วนการเบลนด์ที่อุณหภูมิ 250°C.....	105
4.37 เทอร์โมแกรม TGA ของพอลิเมอร์เบลนด์ที่เตรียมจาก NR-g-HPM/Nylon 6 ที่อุณหภูมิ 230°C ที่เปรียบอัตราส่วนยางต่อพลาสติกเปรียบเทียบกับไนลอน 6.....	106
4.38 เทอร์โมแกรม DTG ของพอลิเมอร์เบลนด์ที่เตรียมจาก NR-g-HPM/Nylon 6 ที่อุณหภูมิ 230°C ที่เปรียบอัตราส่วนยางต่อพลาสติกเปรียบเทียบกับไนลอน 6.....	107

รายการรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.39 เทอร์โมแกรม TGA ของพอลิเมอร์เบลนด์ที่เตรียมจาก NR-g-HPM/Nylon 6 ที่อุณหภูมิ 240°C ที่แบร็อคตราส่วนบางต่อพลาสติกเปรียบเทียบกับไนลอน 6.....	109
4.40 เทอร์โมแกรม DTG ของพอลิเมอร์เบลนด์ที่เตรียมจาก NR-g-HPM/Nylon 6 ที่อุณหภูมิ 240°C ที่แบร็อคตราส่วนบางต่อพลาสติกเปรียบเทียบกับไนลอน 6.....	109
4.41 เทอร์โมแกรม TGA ของพอลิเมอร์เบลนด์ที่เตรียมจาก NR-g-HPM/Nylon 6 ที่อุณหภูมิ 250°C ที่แบร็อคตราส่วนบางต่อพลาสติกเปรียบเทียบกับไนลอน 6.....	111
4.42 เทอร์โมแกรม DTG ของพอลิเมอร์เบลนด์ที่เตรียมจาก NR-g-HPM/Nylon 6 ที่อุณหภูมิ 250°C ที่แบร็อคตราส่วนบางต่อพลาสติกเปรียบเทียบกับไนลอน 6.....	111